

Schweizerischer Plattenverband **SPV**
Association Suisse du Carrelage **ASC**
Associazione Svizzera delle Piastrelle **ASP**



CERUNIQ

Verband der führenden Verlegeunternehmen und des Fachhandels
Associazione esperti nella posa e commercio specializzato
Association des leaders de la pose et de la distribution spécialisée



PCI[®]
Für Bau-Profis
A SIKA BRAND.

Herzlich Willkommen in Dagmersellen!



(kritische) Untergründe

- mit dünn-schichtigen Fussbodenheizungen

Anforderung an den Untergrund

- tragfähig
- fest
- frei von losen Teilen

- frei von trennenden Schichten
(bei Verbundkonstruktionen)



mögliche Lösungen



ausgleichen



verstärken



trennen



sprengen



(kritische) Untergründe vorbereiten

ausgleichen im Verbund bis 50 mm



ausgleichen im Verbund bis 50 mm

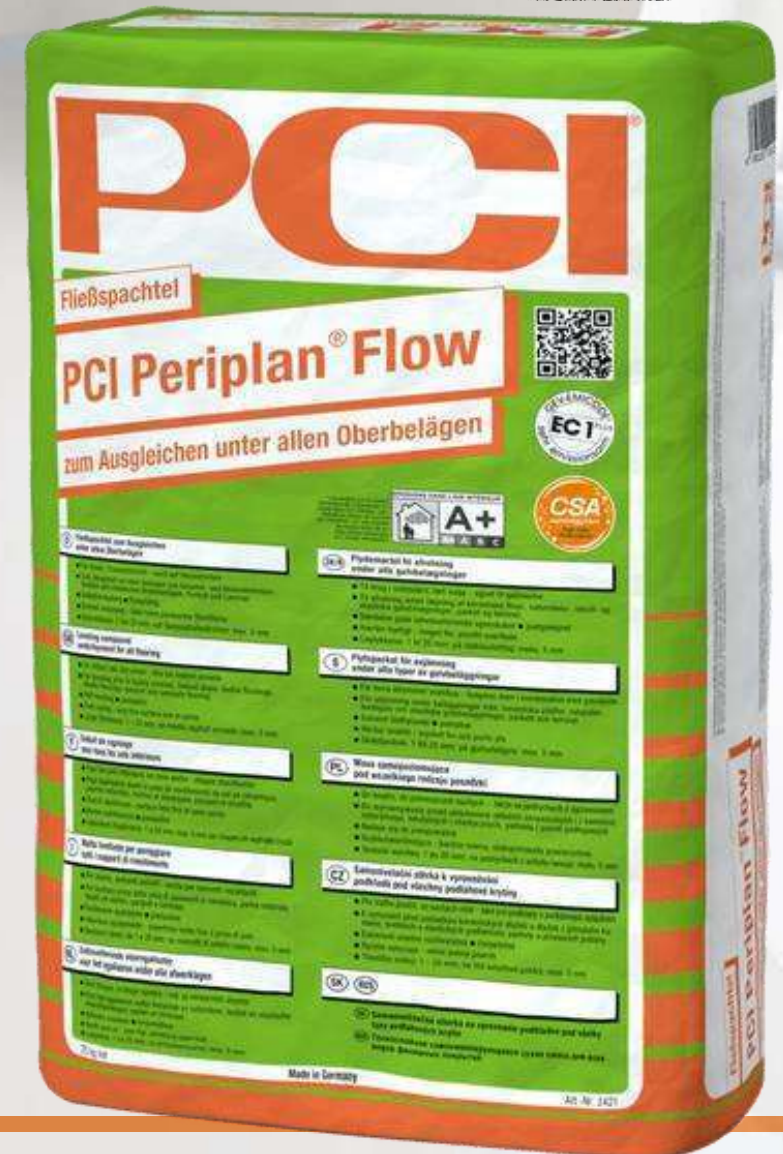
PCI Periplan® Flow

PCI[®]
Für Bau-Profis

A SIKA BRAND.

Fliessspachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen

- Für innen.
- Für Trockenbereiche.
- Unter Abdichtung auch im privaten Nassbereich.
- Zum Ausgleich von rauen, unebenen Betonböden, Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen sowie Keramikbelägen.
- Schichtdicken 0,5-50mm.
- Extrem leicht verlaufend.
- Selbstentlüftend.
- Schnell erhärtend, nach ca. 2 Stunden begehbar und mit keramischen Platten belegbar.
- Sehr Emissionsarm.



CSA-Technologie Das steckt dahinter:



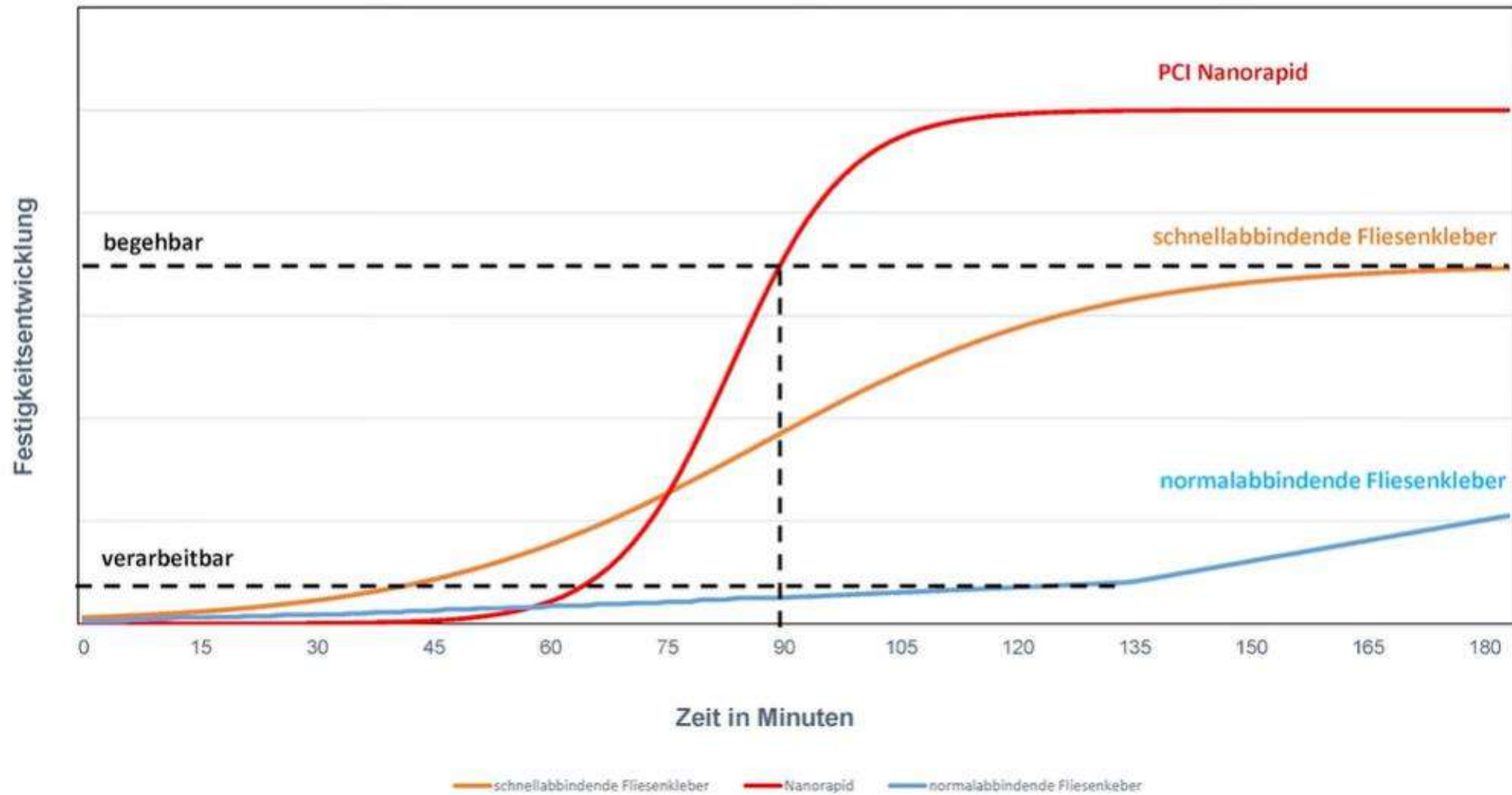
Die von PCI zum Patent angemeldete CSA-Technologie sorgt durch den Einsatz von Calcium-Sulfoaluminat-Zement (sog. CSA-Zement) bei PCI Nanorapid zu einem schnelleren Erstarren sowie einer höheren Frühfestigkeit, was wiederum den Baufortschritt beschleunigt.

Der Herstellungsprozess erfolgt bei wesentlich geringeren Brenntemperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Zementen, wodurch weniger Energie verbraucht und der CO₂ Fußabdruck gesenkt wird.

Das Ergebnis: Eine komplett neue Rezeptur mit, gegenüber vergleichbaren Klebemörteln, verbesserten Produkt- und Verarbeitungseigenschaften auf Basis nachhaltiger Rohstoffe.



Vergleich Abbindeverhalten PCI Nanorapid mit "konventionellen" Fliesenklebern



ausgleichen bis 80 mm



ausgleichen bis 80 mm

PCI Novoment Flow

PCI[®]
Für Bau-Profis

Fliessspachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen

- Für Innen und Aussen.
- Für schnell belegereife Verbundestriche sowie Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht.
- Für Heizestriche geeignet.
- Schichtdicken im Verbund 20-80 mm.
- Auf Trenn- oder Dämmschichten mindestens 30 mm.
- Rohrüberdeckung bei Heizestrichen mindestens 30 mm.
- Schnell abbindend, nach ca. 6 Stunden begehbar, nach 1 Tag mit keramischen Platten belegbar.
- Lange Verarbeitungszeit von 1 Stunde.
- Feuchtigkeitsunempfindlich.
- Sehr Emissionsarm.



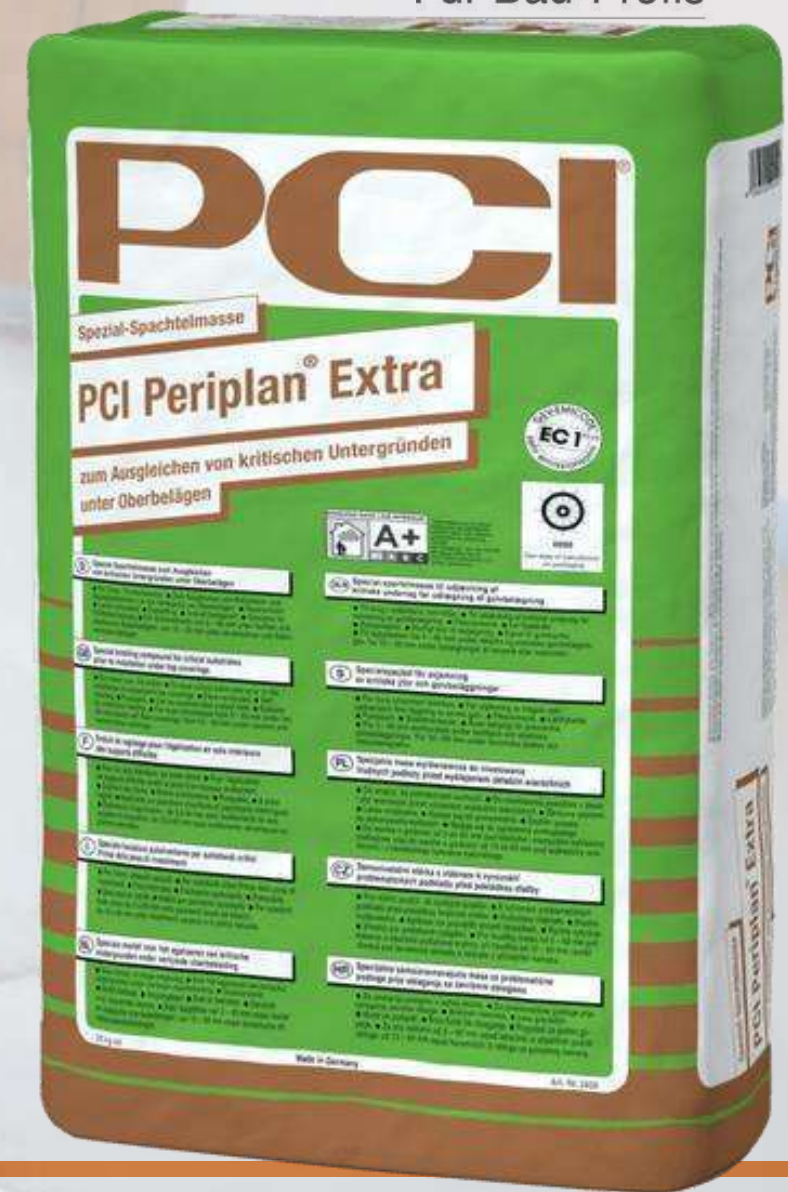
verstärken

PCI Periplan Extra

PCI[®]
Für Bau-Profis

Spezial- Spachtelmasse zum Ausgleichen von kritischen Untergründen unter Oberbelägen.

- Für Innen.
- Faserarmiert.
- Leichtverlaufend.
- Zum Ausgleichen von Holzdielenböden, OSB Platten, Spanplatten, mineralischen Untergründen, nicht saugenden Untergründen, Gussasphalt.
- Schichtdicken 3-60mm.
- Schnell abbindend, nach ca. 3 Stunden begehbar und nach 1 Tag mit keramischen Platten belegbar.
- Saubarm.
- Sehr Emissionsarm.

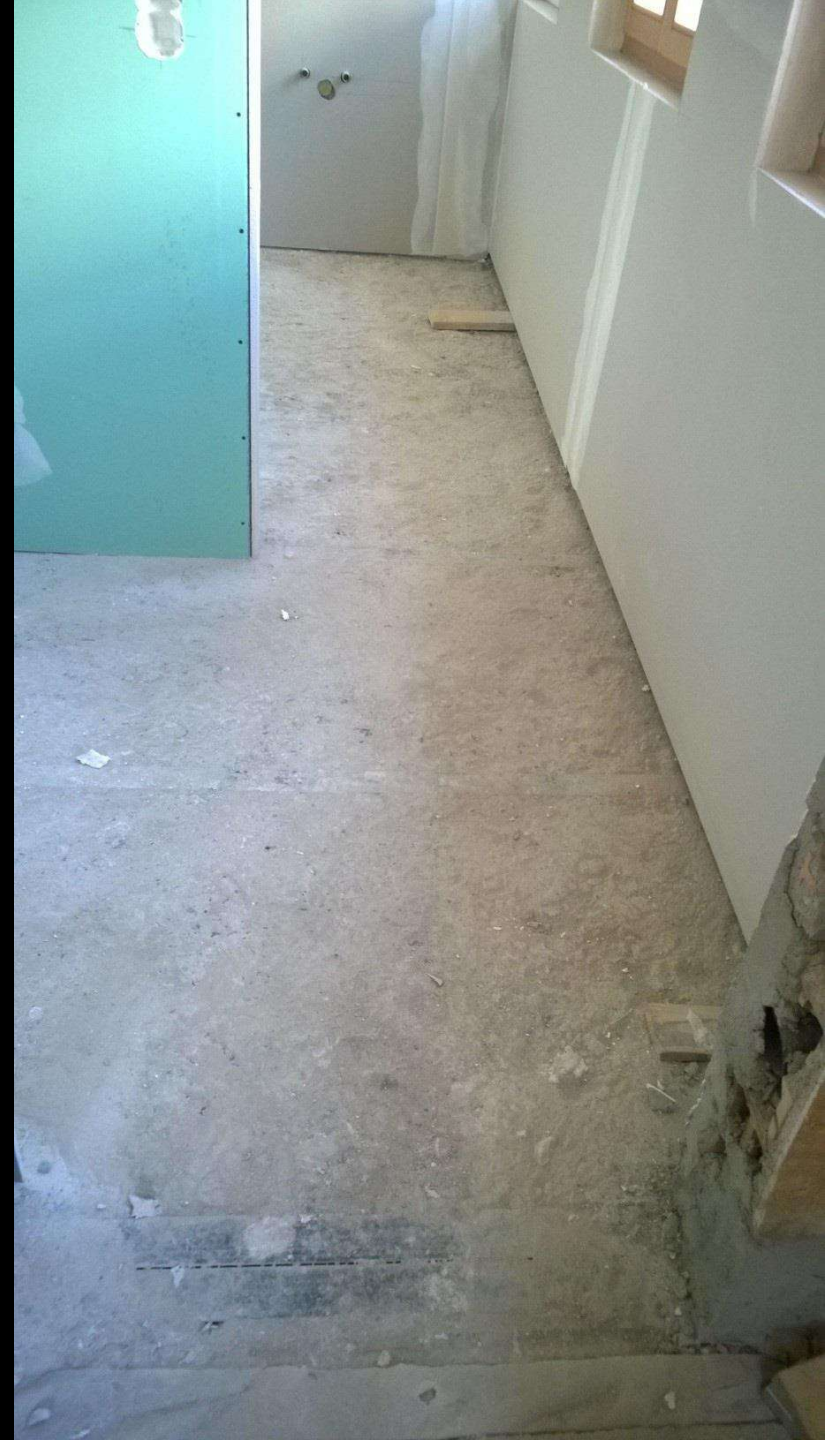


Am Anfang steht der Kundenwunsch

Objekt aus der Praxis - Sanierung mehrstöckiges Wohn- und Geschäftshaus.

Ist:

- Mischuntergründe mit z.T. tiefen Traglasten,
- geringe Raumhöhen,
- Türschwellen, schiefe Böden und unterschiedliches Niveau,
- Schallübertragung / Schallbrücken,
- grosse Lasten im EG durch Geschäftsräume (Apotheke).



Am Anfang steht der Kundenwunsch

Objekt aus der Praxis - Sanierung mehrstöckiges Wohn- und Geschäftshaus.

Soll:

- Ausgleich und Verstärkung des Untergrundes,
- barrierefreie und ebene Wohnfläche,
- so wenig zusätzliches Gewicht wie nötig,
- höhere Behaglichkeit durch Fussbodenheizung.
- Schallbrücken und «knarren» minimieren/eliminieren,

Und dies alles mit möglichst kurze Einbau- und Austrocknungszeiten.

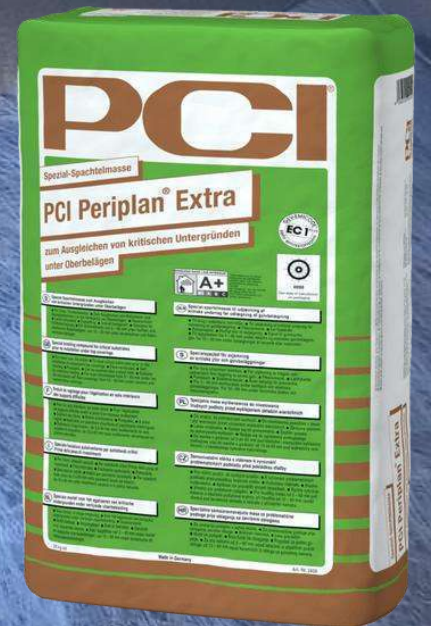


grundieren

Zweck / Eigenschaften

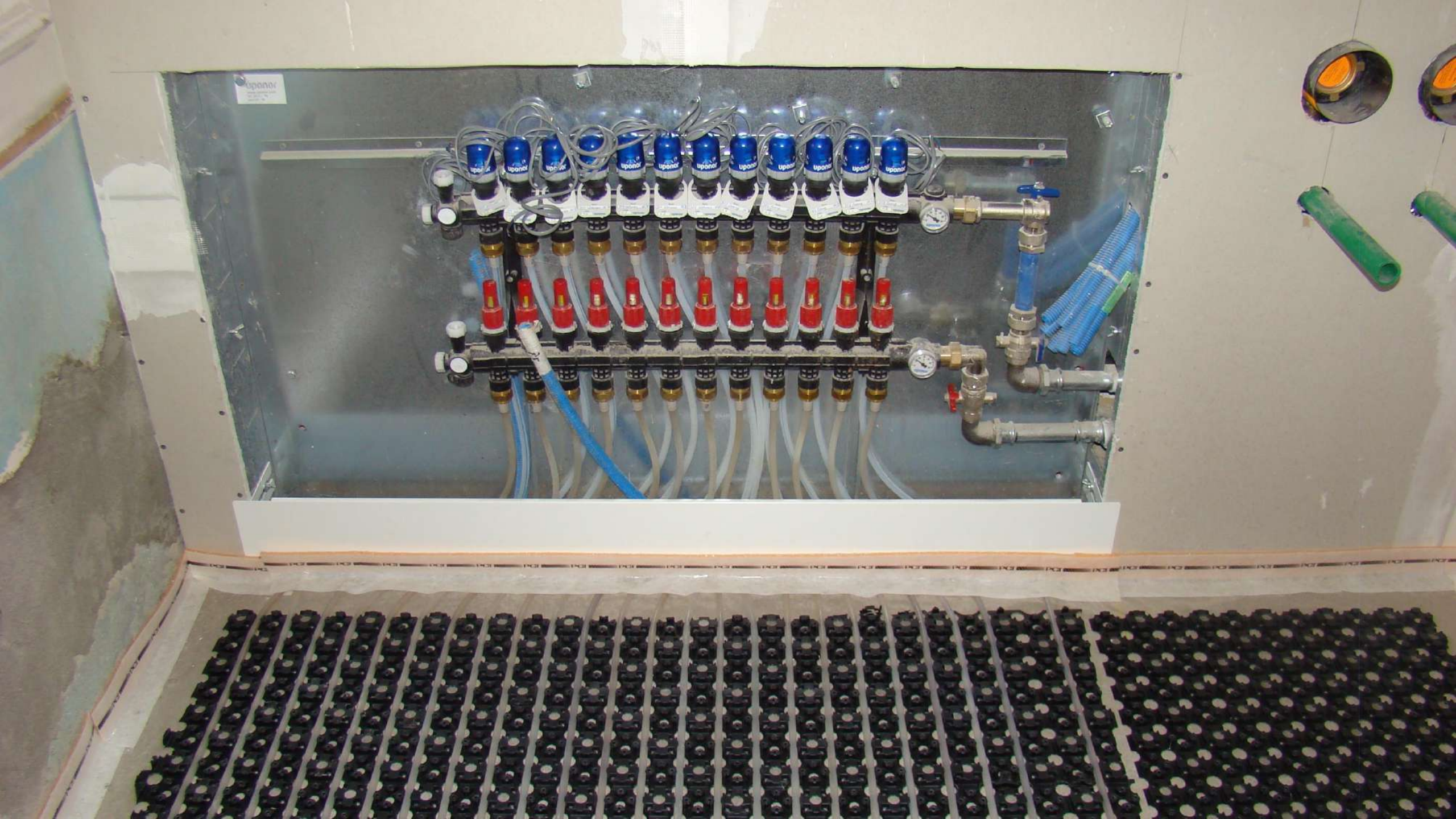
Aufgabe der Grundierung

- Reststaub binden
- Verbundhaftung sichern
- Saugverhalten regulieren
- Feuchtigkeitssperre
- Gips und Zement trennen
- Vermeiden von Feuchteintrag in den Untergrund

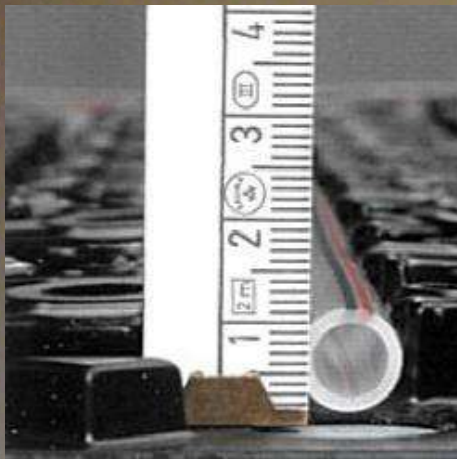






















**LEISTUNGS-
DRUCK**

Lassen Sie
sich beraten



Bei Vitaminmangel infolge erhöhter
mentaler oder körperlicher Belastungen.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Vitamin B
Vitamin C
Calcium
Magnesium
Zink



www.berocca.ch



Systemaufbau Uponor Minitec auf Holzuntergrund

Ziel: geringes Flächengewicht, geringe Aufbauhöhe, schnelle Baustelle

- 1** **Wand und Boden:** 2 x grundieren von Holzuntergründen mit PCI Gisogrund[®] 404 1:1 mit Wasser verdünnt
- 1a** **Alternativ am Boden:** Grundierspachtelung aus PCI STL 39 mit PCI Gisogrund[®] 404 angemischt
- 2** PCI PowerBoard[®]-Platte vollflächig auf den Holzuntergrund verkleben mit PCI Flexmörtel[®] S1 Rapid und, nach Erhärtung des Fliesenklebers, verdübeln (5 Dübel/m²)
- 3** Randstellstreifen PCI Pecitape[®] Silent
- 4** Dünnschicht-Bodenheizungssystem am Untergrund fixieren nach Herstellerangaben
- 5** Ausnivellieren mit PCI Periplan[®] Extra Rohrüberdeckung mind. 5 mm
- 6** Keramische Platten verlegen mit PCI Flexmörtel[®] S1 Flott
- 7** Verfugen mit PCI Nanofug[®] Premium
- 8** Elastische Bewegungsfugen mit PCI Silcofug[®] E



Grundierspachtelung

Risse oder Spalten in Holzdielenböden können mit der standfesten und füllenden Grundierspachtelung (PCI STL 39 mit Zugabe von PCI Gisogrund[®] 404) überarbeitet und geschlossen werden. Nach ausreichender Trocknungszeit der Grundierspachtelung kann direkt und ohne weitere Grundierungsschichten z. B. mit PCI Periplan[®] Extra ausgeglichen werden. Wenn nötig, kann die Ausgleichsschicht dabei auch hier mit PCI Armiermatte GFM zusätzlich verstärkt werden.

Systemaufbau Uponor Minitec auf Holzuntergrund

Ziel: geringes Flächengewicht, geringe Aufbauhöhe, schnelle Baustelle

Gegenüberstellung der Bodenaufbauten

Links: Bodenaufbau auf Trennlage mit wasserführender Bodenheizung nach Norm SIA.

Rechts: Systemaufbau PCI mit Dünnschicht-Fussbodenheizsystem im Verbund. Was sofort auffällt, ist der Höhenunterschied zwischen den zwei Systemen. Mit der PCI-Systemlösung wird die Ausgleichsschicht im Verbund mit dem Untergrund und in einer Gesamthöhe von ca. 15 mm

aufgebaut. Verglichen mit herkömmlichen zementösen Heizestrichen spart man hierbei knapp 80 % an Aufbauhöhe ein. Dies entspricht einer Gewichtseinsparung von bis zu 110 kg pro m²! Zusätzlich spart der PCI-Systemaufbau auch deutlich Kosten, was Material und Verarbeitung betrifft.



Untergrund vorbereiten	<p>Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein. Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Boden für die Verlegung von Fliese, Mosaik und Naturstein</p>		
Grundieren	<p>PCI Gisogrund® 404</p>		
Fußbodenheizung verlegen	<p>Installation des Uponor Minitec Flächenheizungssystems. Nach den Vorgaben des Herstellers</p>		
Ausgleich	<p>PCI Periplan® Extra</p> <p>Mindestüberdeckung der Noppen: 3 mm; Mindestüberdeckung über den Systemrohren: 5 mm</p>		
Fliesenkleber	<p>PCI Flexmörtel® S1</p>	<p>PCI Flexmörtel® S1 Flott</p>	<p>PCI Carrament® grau oder PCI Carrament® weiß</p>
Fugenmörtel	<p>PCI Nanofug® Premium</p>		
Belag	<p>Fliese / Mosaik</p>	<p>Großformat</p>	<p>Naturstein</p>

Systemaufbau Uponor Minitec auf Holzuntergrund

Ziel: auf Dämm- / Trennlage, geringe Aufbauhöhe

- 1 Trittschalldämmung
- 2 Trennlage / Trennfolie
- 3 PCI PowerBoard[®]-Platte vollflächig auf den Holzuntergrund verkleben mit PCI Flexmörtel[®] S1 Rapid und, nach Erhärtung des Fliesenklebers, verdübeln (5 Dübel/m²)
- 4 Randstellstreifen
- 5 Lastverteilschicht aus PCI 2K Bauharzmörtel, Schichtdicke mind. 20 mm
- 6a **Wand:** 2 x grundieren von Holzuntergründen mit PCI Gisogrund[®] 404 1:1 mit Wasser verdünnt
- 6b **Boden:** Grundieren des Bauharzmörtels mit PCI Gisogrund[®] 404 unverdünnt
- 7 Dünnenschicht-Fussbodenheizungssystem
- 8 PCI Periplan[®] Extra, Rohrüberdeckung mind. 5 mm
- 9 Keramische Platten verlegen mit PCI Flexmörtel[®] S1
- 10 Verfugen mit PCI Nanofug[®] Premium
- 11 Elastische Bewegungsfugen mit PCI Silcofug[®] E



Systemaufbau Uponor Minitec auf Holzuntergrund

Ziel: auf Dämm- / Trennlage, geringe Aufbauhöhe

Gegenüberstellung der Bodenaufbauten

Ist im Gegensatz zum vorhergehenden System eine Wärmedämmung und Trittschallverbesserung erwünscht, kann nachfolgender Aufbau angewendet werden:

Links: Bodenaufbau auf Trittschall-, Dämm- und Trennlage mit wasserführender Bodenheizung nach Norm SIA.

Rechts: Systemaufbau PCI mit Dünnschicht-Fussbodenheizsystem auf Trittschall-, Dämm- und Trennlage. Auch hier fällt der beachtliche Höhenunterschied zwischen den zwei Systemen sofort auf.

Mit der PCI-Systemlösung wird erst eine Lastverteilschicht mit einem Bauharzmörtel in einer Mindestschichtdicke von 20 mm eingebracht. Darauf kann nun das Dünnschicht-Fussbodenheizsystem im Verbund eingebaut werden. Dabei wird, mit ca. 35 mm Systemaufbau und einem Flächengewicht von ca. 65 kg pro m², **die Hälfte der Aufbauhöhe und des Gesamtgewichts** eines konventionellen Zement-Heizestrichs eingespart.



Systemaufbau Bodenheizung auf Holzuntergrund

Ziel: gewichtsoptimiert, schnelle Baustelle

Vorteile PCI-Systemlösung Bodenaufbau auf Trenn- und Dämmlage mit konventioneller Fussbodenheizung

- Geringere Rohrüberdeckung von nur 30 mm gegenüber Zement-Heizestrichen von mind. 50 mm
- Schneller Arbeitsvorschritt unabhängig der Schichtdicke, da bereits **nach ca. 6 Stunden begehbar und nach ca. 1 Tag mit keramischen Platten belegbar**
- **Gewichts- und Kosteneinsparung** gegenüber herkömmlichen Aufbauten durch geringere Aufbauhöhe
- Geringe Gefahr von Verformung und Verschüsselung durch kurze und daher kontrollierbare Abbindezeit
- Verkürzte Aufheizphase gegenüber herkömmlichen Heizestrichen

- 1a Trittschalldämmung
- 1b Trennlage/Trennfolie
- 2 **Wand:** 2 x grundieren von Holzuntergründen mit PCI Gisogrund[®] 404 1:1 mit Wasser verdünnt
- 3 PCI Powerboard[®]-Platte vollflächig auf den Holzuntergrund verkleben mit PCI Flexmörtel[®] S1 Rapid und, nach Erhärtung des Fliesenklebers, verdübeln (5 Dübel/m²)
- 4 Randstellstreifen
- 5 Konventionelle Fussbodenheizung auf Trittschalldämmung fixiert nach Herstellerangaben
- 6 Ausnivellieren mit PCI Novoment[®] Flow Rohrüberdeckung mind. 30 mm
- 7 Keramische Platten verlegen
Boden: PCI Flexmörtel[®] S1 Flott
Wand: PCI Flexmörtel[®] S1
- 8 Verfugen mit PCI Nanofug[®] Premium
- 9 Elastische Bewegungsfugen mit PCI Silcofug[®] E



Systemaufbau Bodenheizung auf Holzuntergrund

Ziel: gewichtsoptimiert, schnelle Baustelle

Gegenüberstellung der Bodenaufbauten

Links: Bodenaufbau auf Trenn- und Dämmschicht mit wasserführender Bodenheizung nach Norm SIA.

Rechts: Systemaufbau mit PCI Novoment[®] Flow. Auch hier ist der Höhenunterschied zwischen den zwei Systemen gut ersichtlich. Diese PCI-Systemlösung benötigt nur mind. 30 mm Rohrüberdeckung und kommt daher mit einer Mindestgesamthöhe, ab Trennlage, von nur 50 mm aus.

Somit können auch hier, gegenüber der Verwendung von herkömmlichen zementösen Heizestrichen, **ca. 20 mm der Aufbauhöhe** eingespart werden. Dies entspricht einer Gewichtseinsparung von ca. 40 kg pro m².

Durch die Einfachheit des Aufbaus, die schnelle Abbindezeit und die günstigere Materialwahl im Vergleich zu anderen Systemen ist auch dieses PCI-System eine sehr gute Wahl.




Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

Schlüter Bekotec EN / EN-F / EN-FTS / EN-FK

PCI[®]
Für Bau-Profis
A SIKA BRAND.



Quelle: https://www.bekotec-therm.de/images/cumulus/ss_mil_bekotecenpf_001_a.tif_rdx_960x537_65s.jpg

Untergrund vorbereiten	nach baulichen Erfordernissen Der Verlegeuntergrund muss eben und belegbar sein.			
Fußbodenheizung verlegen	Verlegen nach Herstellerangaben			
Estrich	PCI Novoment® Flow Schichtdicke mind. 28 mm (Rohrüberdeckung mind. 8 mm)			
Entkopplung	Schlüter Ditra oder PCI Pecilastic® E		oder PCI Pecilastic® U	
Abdichtung falls erforderlich	Schlüter Ditra oder PCI Pecilastic® U Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W2-I			
Verlegung Boden keramische Fliesen	PCI Flexmörtel® S1 Flott	PCI Flexmörtel® S1	PCI Flexmörtel® S2	PCI Nanolight®
Verlegung Boden Naturwerkstein	PCI Carrament® grau	PCI Carrament® weiß	PCI Carraflex®	PCI Carraroc®
Verfugen für Fliesen und Naturwerkstein	PCI Nanofug® Premium			
Belag	Fliese / Naturstein			

Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

Meier Tobler Compact Floor 12

IDEAL BASIC EPS



- 1 Beliebiger Bodenbelag
- 2 Wärmeleitschicht CompactFloor PRO 12 12 mm
- 3 Fußbodenheizung CompactFloor IDEAL BASIC EPS inkl. Rohr 30 mm
- 4 Rahmenholz (30 mm)
- 5 Randdämmstreifen
- 6 ggf. Feuchtigkeitssperre

42 mm

 Konstruktionsdatenblatt

IDEAL BASIC ÖKO



- 1 Beliebiger Bodenbelag
- 2 Wärmeleitschicht CompactFloor PRO 12 12 mm
- 3 Fußbodenheizung CompactFloor IDEAL BASIC ÖKO inkl. Rohr 30 mm
- 4 Rahmenholz (30 mm)
- 5 Randdämmstreifen
- 6 ggf. Feuchtigkeitssperre

42 mm

 Konstruktionsdatenblatt

Quelle: <https://www.compact-floor.com/de/produkte/waermeleitschichten/compactfloor-pro-12/>

Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

Meier Tobler Compact Floor 12

PCI[®]
Für Bau-Profis
A SIKA BRAND.



Quelle https://www.compact-floor.com/media/image/f2/6e/f7/01_CF-PRO-12.jpg

Weitere dünnsschichtige Fussboden-Heizsysteme

Compact Floor GmbH, Vertrieb in der Schweiz durch Meier Tobler

Verlegeempfehlung für CompactFloor PRO 12 - Fliese und Naturstein

Untergrund vorbereiten	Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein. Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Boden		
Grundierung bei Direktverklebung auf CompactFloor	PCI Gisogrund [®] 1 : 1 mit Wasser verdünnt		
Ausgleich (falls erforderlich)	PCI Periplan [®] Extra in Kombination mit PCI Gisogrund [®] 404		
Abdichtung (falls erforderlich)	PCI Seccoral [®] 1K oder PCI Seccoral [®] 2K Rapid oder PCI Lastogum [®]		
Entkopplung (falls erforderlich)	PCI Pecilastic [®] U oder PCI Polysilent [®]		
Fliesenkleber	PCI Flexmörtel [®] S2	PCI Flexmörtel [®] S2	PCI Carrament [®] weiß oder PCI Carrament [®] grau
Fugenmörtel	PCI Nanofug [®] Premium		
Belag	Fliese / Mosaik Fliesengröße: max. 60 x 60 cm, Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1, Mindeststärke: 9 mm, Bruchkraft: mind. 1500 N, Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Großformat Fliesengröße: max. 60 x 60 cm, Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1, Mindeststärke: 9 mm, Bruchkraft: mind. 1500 N, Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 60 x 60 cm, Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1, Mindeststärke: 15 mm, Bruchkraft: mind. 1500 N, Technische Fugenbreite: mind. 3 mm

Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

Fermacell Therm25

PCI[®]
Für Bau-Profis
A SIKA BRAND.



Bildquelle: <https://www.fermacell.ch/ch/boden/therm25-fussbodenheizung>

Weitere dünnsschichtige Fussboden-Heizsysteme

Fermacell Therm25

02 Eigenschaften und Vorteile

2.1 fermacell® Therm25™ Element

Systembeschreibung

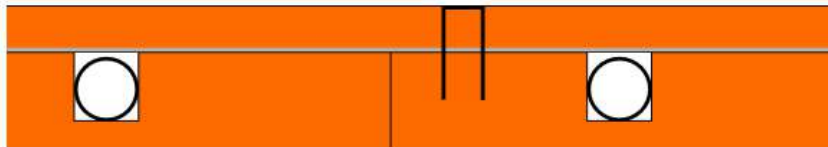
Das fermacell® Therm25™ Element ist eine Weiterentwicklung der fermacell™ Bodensysteme mit Fussbodenheizung. Das Therm25™ Element bietet weitere Anwendungsmöglichkeiten für schlanke Aufbauten (z. B. als Verlegung auf bestehenden Unterlagsböden ohne Fussbodenheizung).

fermacell® Therm25™ Elemente bestehen aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht.

Zum System gehörend ist eine weitere 10 mm fermacell® Gipsfaser-Platte, welche als zusätzliche Lage oberhalb oder unterhalb der fermacell® Therm25™ Elemente verleimt und geschraubt/geklammert wird.

Das System ist ausgerichtet, um 16 mm Verbund-Heizrohre verlegen zu können. Das Rastermass der Ausfräsungen beträgt 167 mm. Für eine verbesserte Wärmeleistung mit geringerem Rohrabstand, z. B. für Nassräume, werden Elemente mit einem Nutabstand von 125 mm angeboten. Das handliche Format von 500 x 1 000 mm ermöglicht eine einfache und „leichte“ Verlegung.

Systemaufbau:



Standardverlegung:

- oberseitig Abdeckung mit einer zusätzlichen fermacell® Gipsfaser-Platte, auf fermacell® Therm25™ Element vollflächig verklebt und fixiert

Alternative Systemaufbauten:



Variante 1:

- unterseitig zusätzliche fermacell® Gipsfaser-Platte, fermacell® Therm25™ Element wird darauf vollflächig verklebt und fixiert
- oberseitige, vollflächige Spachtelung



Variante 2*:

- fermacell® Therm25™ Element wird vollflächig auf den ebenen, tragfähigen Untergrund verklebt
- oberseitige, vollflächige Spachtelung
- *Hinweis: keine Schall- bzw. brandschutztechnischen Verbesserungen der Rohdecke durch fermacell® Therm25™ Elemente

7.3 Keramik- und Werksteinbeläge (z.B. Fliesen, Naturstein)

Mögliche Beläge (abhängig vom Bodenaufbau):

Standardformate	max. Kantentlänge	Dicke
Keramische Fliese allgemein	Bis 33 cm	Ohne Einschränkung
Feinsteinzeugfliese	Bis 33 cm	Ohne Einschränkung
Naturwerkstein * / Betonwerkstein	Bis 33 cm	Ohne Einschränkung
Terrakotta	Bis 40 cm	Ohne Einschränkung

Grossformate	max. Kantentlänge	Dicke
Grossformatige Feinsteinzeugfliese	Ohne Einschränkung	≤ 6 mm
Grossformatiger Naturwerkstein *	Bis 80 cm	≤ 15 mm
Grossformatiger Naturwerkstein *	Bis 120 cm	≤ 20 mm

*Informationen zum Naturwerkstein finden Sie in der vollständigen Verarbeitunganleitung „Fliesenbeläge auf fermacell™ Bodensystemen“

Besonderheiten:

Bei Estrich-Aufbauten mit Mineralwolle ist eine Verlegung von Naturwerkstein bzw. Terrakotta nicht zugelassen.

Ein Vorwärmen der Fliesen ist nicht zulässig.

Eine vollflächige Belagung der Fliesen im Kleber ist anzustreben. Wir empfehlen, für Standard- sowie Grossformate, das kombinierte Verfahren (Buttering-Floating), bei dem sowohl der Verlegeuntergrund als auch die Fliesenrückseite mit Kleber versehen wird.

Die Verlegung der Fliesen ist in jedem Fall mit einer offenen Fuge auszuführen. Die Fliesen stumpf zu stossen, ist nicht zulässig.

Kleben/Verlegen:

Standardformate:

Auf fermacell® Therm25™ Elementen erfolgt die Fliesenverlegung nur im Dünnbettverfahren. Auf fermacell® Therm25™ Elementen mit fermacell® Powerpanel H₂O als Abdecklage kann die Verlegung der Fliesen im Dünn- oder Mittelbettverfahren erfolgen.

Für Fussböden mit Betonwerkstein-Fliesen sind spezielle Fliesenklebersysteme zu verwenden, die ausdrücklich vom Klebersystemhersteller für das jeweilige Estrich-Element freigegeben sind.

Grossformate:

Die Verlegung von grossformatigen Fliesen erfordert besondere Anforderungen an die Rohdecke. Diese muss ausreichend biegesteif sein, d.h. es ist eine max. Durchbiegung von 1/500 zulässig. Mögliche Rohdecken sind, z.B.:

Massivdecke
Holzbalkendecke, mit der Begrenzung der max. Durchbiegung der Deckenbalken und der oberen, tragenden Beplankung auf max. U/500
Holzbalkendecke mit Einschub
Stahlträgerdecke
Stahlträgerblechdecke
Brettstapeldecke
Brettsperrholzdecke

Auf fermacell® Therm25™ Elementen und fermacell® Therm25™ Elemente mit fermacell® Powerpanel H₂O als Abdecklage erfolgt die Fliesenverlegung nach Empfehlung der Hersteller (siehe Verarbeitungsrichtlinien). Für Fussböden mit grossformatigen Feinsteinzeug- und Naturwerkstein-Fliesen sind spezielle Fliesenklebersysteme zu verwenden, die ausdrücklich vom Klebersystemhersteller für das jeweilige Estrich-Element und die Fliesengrösse freigegeben sind.

Die Feldgrössen des Belags sind durch Anordnung von Bewegungsfugen unterschiedlich einzustellen mit maximalen Feldlängen von 8 m.
· Ohne Fussbodenheizung max. 64 m²
· Mit Fussbodenheizung max. 40 m²
Fliesengeometrien sind nicht in ihrem Seitenverhältnis beschränkt.



Weitere Informationen

Die vollständige Verarbeitungsrichtlinie „Fliesenbeläge auf fermacell™ Bodensystemen“ finden Sie unter:
www.fermacell.ch/fliesenbelag



Weitere dünnsschichtige Fussboden-Heizsysteme

Fermacell Therm25



Verlegeempfehlung auf fermacell Gipsfaser Estrich-Element bzw. fermacell Therm25, Fliese/Naturstein



Untergrund vorbereiten	<p>Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein. Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Boden</p>	
Untergrund	<p>Fachgerechtes Verlegen nach Herstellervorgaben fermacell Gipsfaser Estrich-Element bzw. fermacell Therm25</p> <p>Die Herstellerangaben bzgl. der Anwendung in Feuchträumen und den zulässigen Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534 sind zu beachten.</p>	
Grundieren	<p>Haft- und Schutzgrundierung PCI Gisogrund[®] 404 1:1 mit Wasser verdünnt</p>	
Ausgleich Ausgleich ist nur erforderlich, wenn Untergründe uneben sind.	<p>Boden-Ausgleich PCI Periplan[®] Extra</p>	
Abdichtung	<p>AIV-F PCI Seccoral[®] 1K</p>	
Verlegung Boden	PCI Flexmörtel[®] S1 Flott	PCI Carrament[®] grau
Verfugen für Fliesen und Naturwerkstein	PCI Nanofug[®] Premium	
Belag	Fliese / Mosaik	Naturstein

Dieses Dokument ist als allgemeine Aufbauempfehlung zu verstehen. Objektbezogene Abweichungen sind möglich. Ggf. technische Beratung einholen. Die Verarbeitung erfolgt nach den technischen Merkblättern der aufgeführten Produkte.

Stand: 01/2023

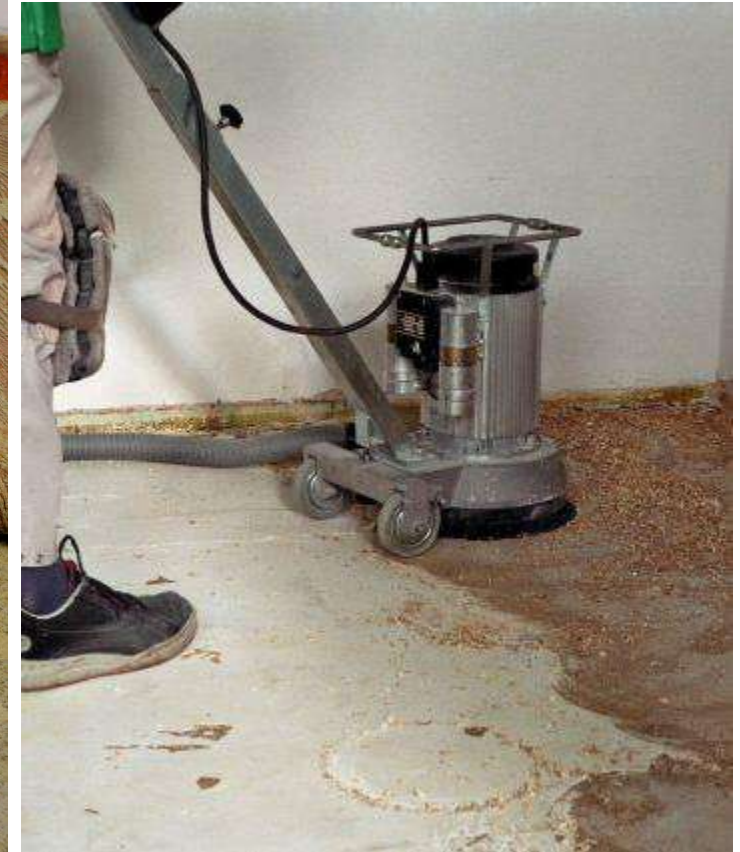
Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

JK Fussbodenheizung GmbH

PCI[®]
Für Bau-Profis
A SIKA BRAND.



Bildquelle: https://www.immoportal.com/sites/default/files/2021-11/teppichboden-entfernen_simazoran_immoportal.com_.jpg



Bildquelle: <https://www.saniermeister.com/images/bilder/bodenbelag-entfernen/schaumruecken/schaumruecken02.jpg>

Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

JK Fussbodenheizung GmbH



Unterbau:
1. Untergrund im Bestand z.B. Estrich
(sauber und tragfähig)
Altbeläge entfernen,
saubere Estrichoberfläche herstellen



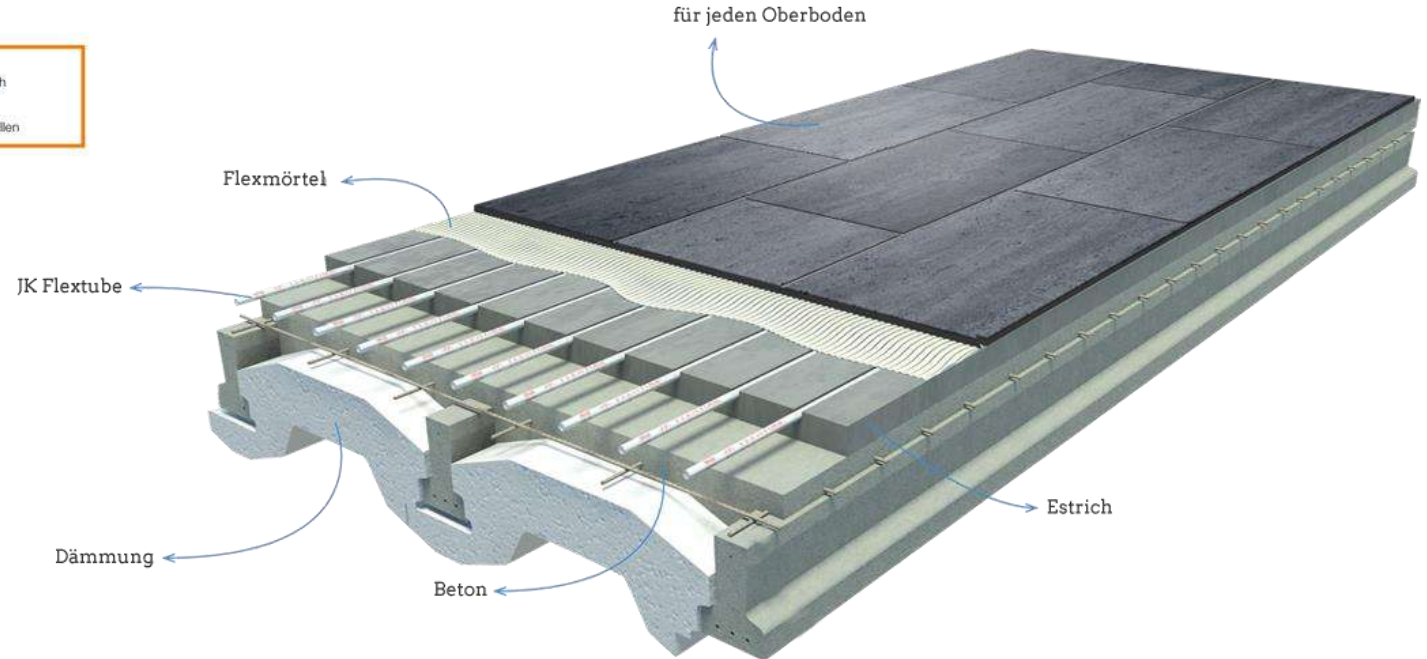
2. EINBAU

- Schlitzte fräsen und Heizschläuche einlegen



3. VERFÜLLEN/AUSGLEICHEN

- PCI Periplan Extra – Spezial-Spachtelmasse zum Ausgleichen von kritischen Untergründen unter Oberbelägen
- PCI Periplan Flow – Fließspachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen



Bildquelle: <https://www.jk-de.com/images/vloerdoorsnede.png>

Ein System – viele Vorteile:

- Kein Ausbau des bestehenden Estrichs
- Keine zusätzliche Aufbauhöhe, da Heizleitungen in den ausgefrästen Schlitzten verlegt werden
- Energieeffizient und umweltschonend durch Umrüstung auf Fußbodenheizung mit geringer Vorlauftemperatur

Weitere dünnsschichtige Fussboden-Heizsysteme

JK Fussbodenheizung GmbH



Verlegeempfehlung für die J-K Fußboden- heizung, Fliese und Naturstein



Untergrund vorbereiten	Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein.		
Fußbodenheizung verlegen	In den tragfähigen Zement- oder Calciumsulfatestrich werden mit einer Tiefe von ca. 15 mm Nuten eingefräst und die Heizrohre gemäß den Herstellerangaben verlegt.		
Grundierung	PCI Gisogrund [®] 404		
Ausgleich	PCI Periplan [®] Extra		
Fliesenkleber	PCI Flexmörtel [®] S1	PCI Flexmörtel [®] S1 Flott	PCI Carrament [®] grau PCI Carrament [®] weiß
Fuge	PCI Nanofug [®] Premium		
Belag	Fliese / Mosaik	Großformat	Naturstein

Dieses Dokument ist als allgemeine Aufbauempfehlung zu verstehen. Objektbezogene Abweichungen sind möglich. Ggf. technische Beratung einholen. Die Verarbeitung erfolgt nach den technischen Merkblättern der aufgeführten Produkte.

Stand: 01/2023

Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

Lofec Flächenheizung

PCI[®]
Für Bau-Profis
A SIKA BRAND.

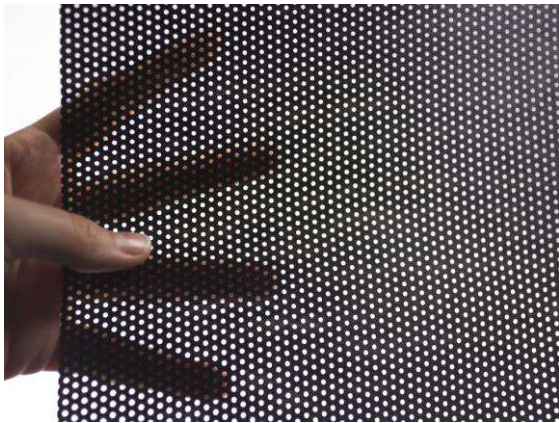


Bildquelle: <https://www.jordanshop.de/upload/Landingpage-Fu%C3%9Fbodenheizung-Lofec-Jordan.jpg>

Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

Lofec Flächenheizung

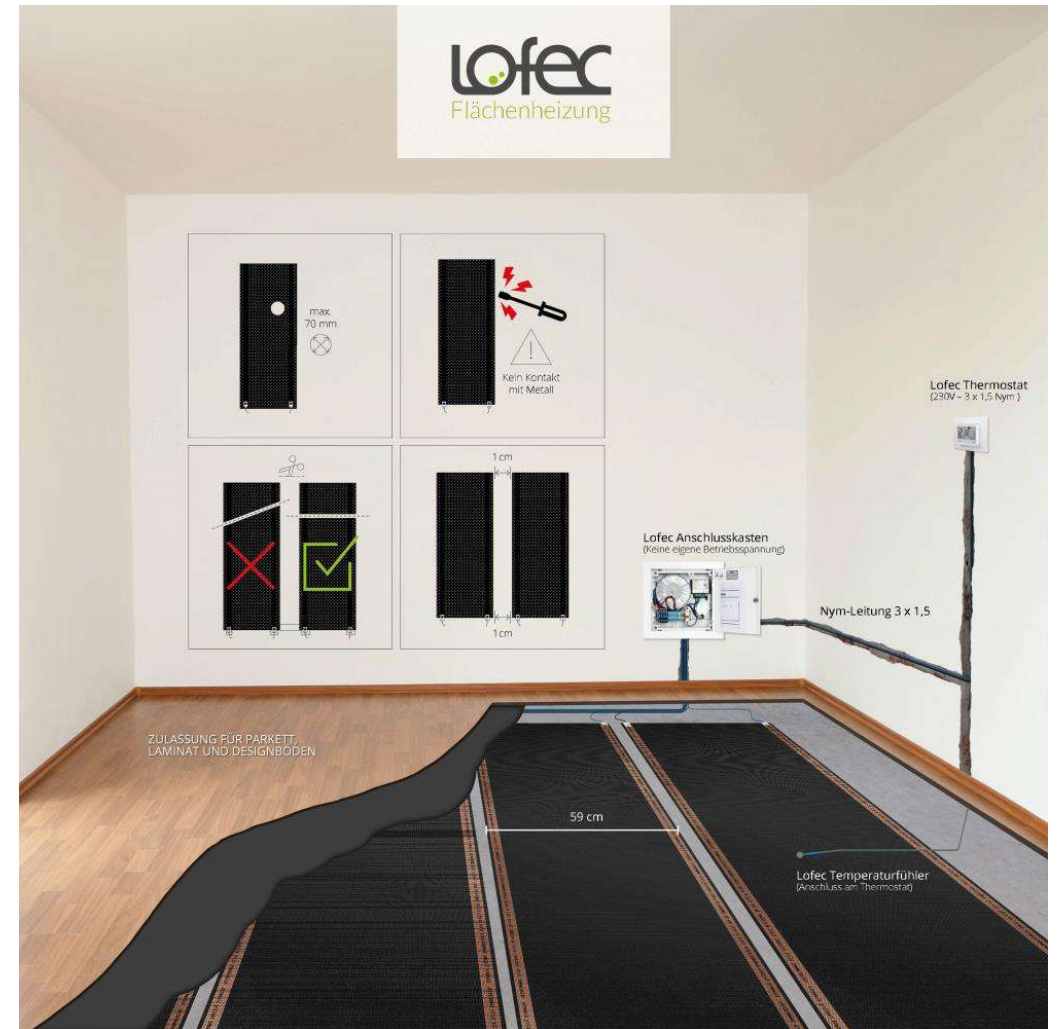
PCI[®]
Für Bau-Profis
A SIKA BRAND.



Bildquelle: https://www.flaechenheizung.de/wp-content/uploads/ultimatemember/76/stream_photo_41c01bd02fa68c3151cac4455e652ace_5fc75376179f8.png



Bildquelle: <https://www.jordanshop.de/upload/Landingpage-Fu%C3%9Fbodenheizung-Lofec-Jordan.jpg>



Bildquelle: https://www.flaechenheizung.de/wp-content/uploads/ultimatemember/76/stream_photo_41c01bd02fa68c3151cac4455e652ace_5fc75376179f8.png

Weitere dünnsschichtige Fussboden-Heizsysteme

Lofec Flächenheizung



Verlegeempfehlung für Lofec Heizsystem - Fliese und Naturstein



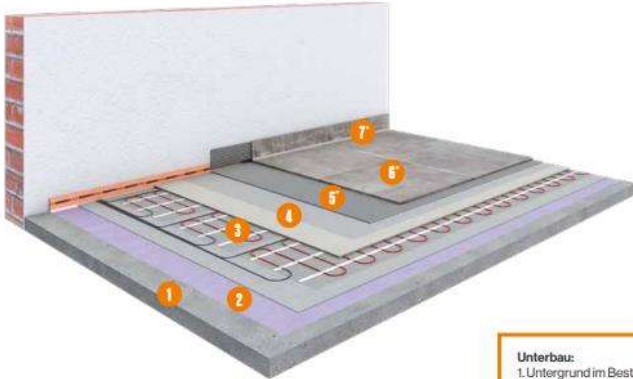
Untergrund vorbereiten	Der Verlegeuntergrund muss frei von haftungsfeindlichen Schichten, sauber, fest, tragfähig und trocken sein. Weitergehende Informationen zu möglichen vorbereitenden Maßnahmen finden Sie hier: Untergrundvorbereitung Boden		
Grundieren	PCI Gisogrund [®] 404		
Fußbodenheizung verlegen	Installation des Heizsystems nach den Vorgaben des Herstellers PCI Flexmörtel [®] S1 Flott oder PCI Flexmörtel [®] S1 Der Fliesenkleber wird, z. B. mit einer 4 mm-Zahnung, aufgekämmt, das Heizsystem eingelegt und vollflächig überspachtelt.		
Ausgleich (am Boden, falls erforderlich)	PCI Periplan [®] Extra min. 5 mm		
Ausgleich (an der Wand, falls erforderlich)	PCI Pericret [®]		
Abdichtung (falls erforderlich)	PCI Seccoral [®] 1K oder PCI Seccoral [®] 2K Rapid		
Fliesenkleber	PCI Flexmörtel [®] S1	PCI Flexmörtel [®] S1 Flott	PCI Carrament [®] grau PCI Carrament [®] weiß
Fugenmörtel	PCI Nanofug [®] Premium		
Belag	Fliese / Mosaik	Großformat	Naturstein

Dieses Dokument ist als allgemeine Aufbauempfehlung zu verstehen. Objektbezogene Abweichungen sind möglich. Ggf. technische Beratung einholen. Die Verarbeitung erfolgt nach den technischen Merkblättern der aufgeführten Produkte.

Stand: 01/2023

Weitere dünn-schichtige Fussboden-Heizsysteme

Elektro Heizmatten allgemein



Unterbau:
1. Untergrund im Bestand (sauber und tragfähig)
z.B. Estrich, alter Fliesenbelag, Holzdielen



2. GRUNDIEREN

- PCI Gisogrund 404 – Spezial-Haftgrundierung für saugende und nicht saugende Untergründe



3. AUSLEGEN

- Auslegen der Heizmatten nach Herstellerangaben



4. FIXIEREN/AUSGLEICHEN

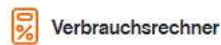
- Fixieren:**
- PCI Nanolight – Leichter variabler Fliesenkleber für alle Untergründe und alle keramischen Beläge zum Fixieren bzw. bei kleineren Flächen zum vollständigen Überspachteln der Fläche

- Ausgleichen:**
- PCI Periplan Extra – Spezial-Spachtelmasse zum Ausgleichen von kritischen Untergründen unter Oberbelägen
 - PCI Periplan Flow – Fließspachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen

Ein System – viele Vorteile:

- Geringe Aufbauhöhe, geringes Flächengewicht
- Einfacher Einbau, ohne den bestehenden Estrich zu entfernen
- Hoher Wärmewirkungsgrad und geringer Energieverlust





SYSTEM-PARTNERSCHAFTEN

Finden Sie den passenden Verleger für Ihr Vorhaben

Broschüren Technische Merkblätter Sicherheitsdatenblätter Nachhaltigkeitsdatenblätter Leistungserklärungen Verbrauchstabellen Protokolle **System-Partnerschaften** Ausschreibungstexte Detailzeichnungen

Schlüter



Rubriken - Alle



Beläge - Alle



System-Partner

Bezeichnung

Beläge

Verlegeempfehlung



Verlegeempfehlung auf Ditra Drain / Ditra Drain 25

Keramik, Naturstein

Jetzt Downloaden



Kontakt



#pci